

平成23年3月期第3Q決算説明会

2011年 1月31日(月) 尼崎

2月 3日(木) 東京

メック株式会社

証券CODE:4971

URL <http://www.mec-co.com/>

プレスリリース

1月31日 期末配当に関するお知らせ

上場10周年記念として
記念配当10円を含む 14円といたします

第42期(平成23年3月期)計画

連結

	平成22年3月期	平成23年3月期				
	前期実績	当初予算	修正予想	今期再修正予想	前期比	増減額
売上高	6,098	6,885	7,314	6,881	112.8	783
営業利益	798	1,098	1,305	978	122.5	179
経常利益	804	1,060	1,264	852	105.9	47
当期純利益	713	716	852	534	74.8	△179

単体

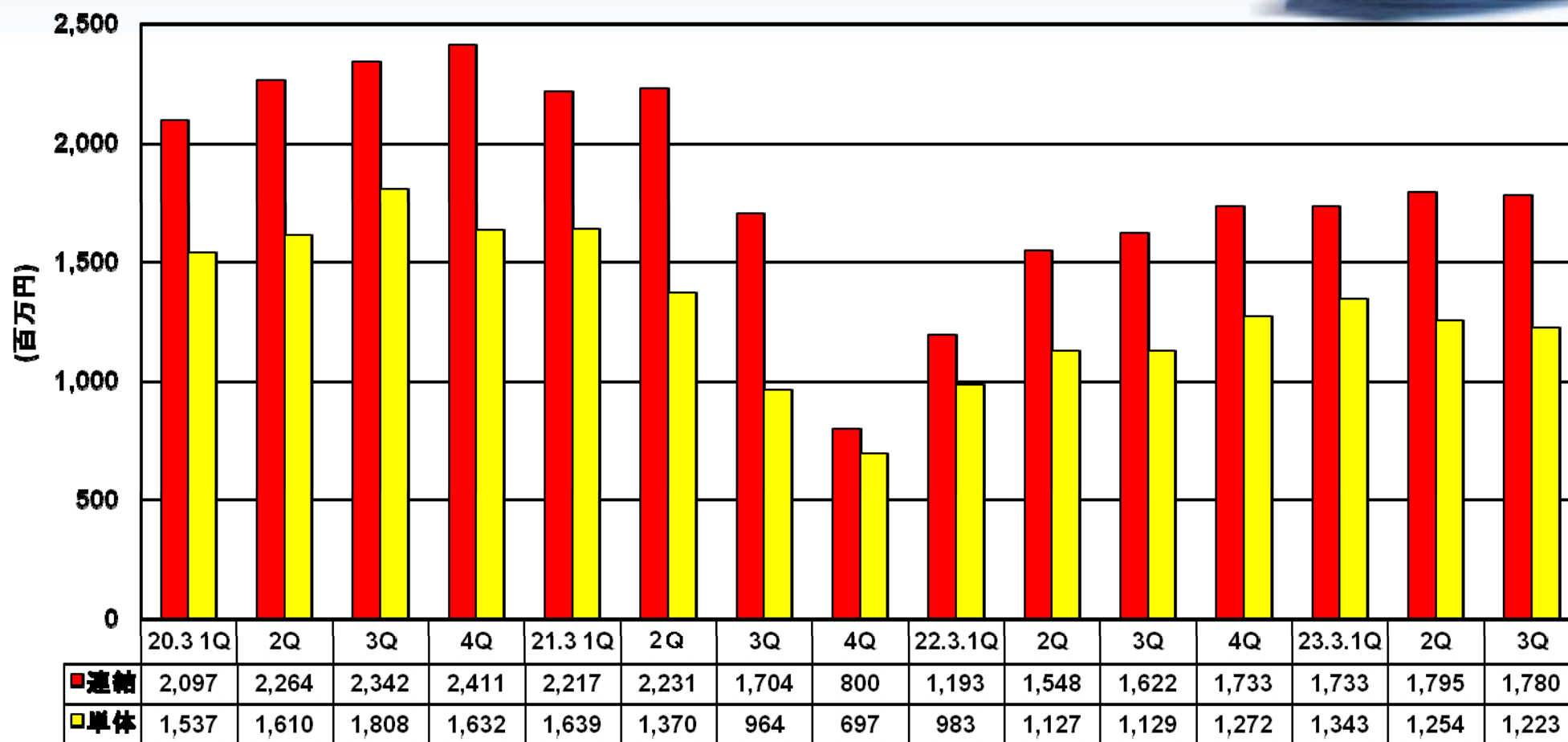
	平成22年3月期	平成23年3月期				
	前期実績	当初予算	修正予想	今期再修正予想	前期比	増減額
売上高	4,512	5,021	5,482	4,987	110.5	474
営業利益	105	305	517	232	219.5	126
経常利益	429	570	779	409	95.4	△19
当期純利益	482	487	629	352	73.0	△130

数字単位は百万円、前期比は%。当初予算は5月14日、修正予想は7月26日、再修正予想は10月27日に公表。

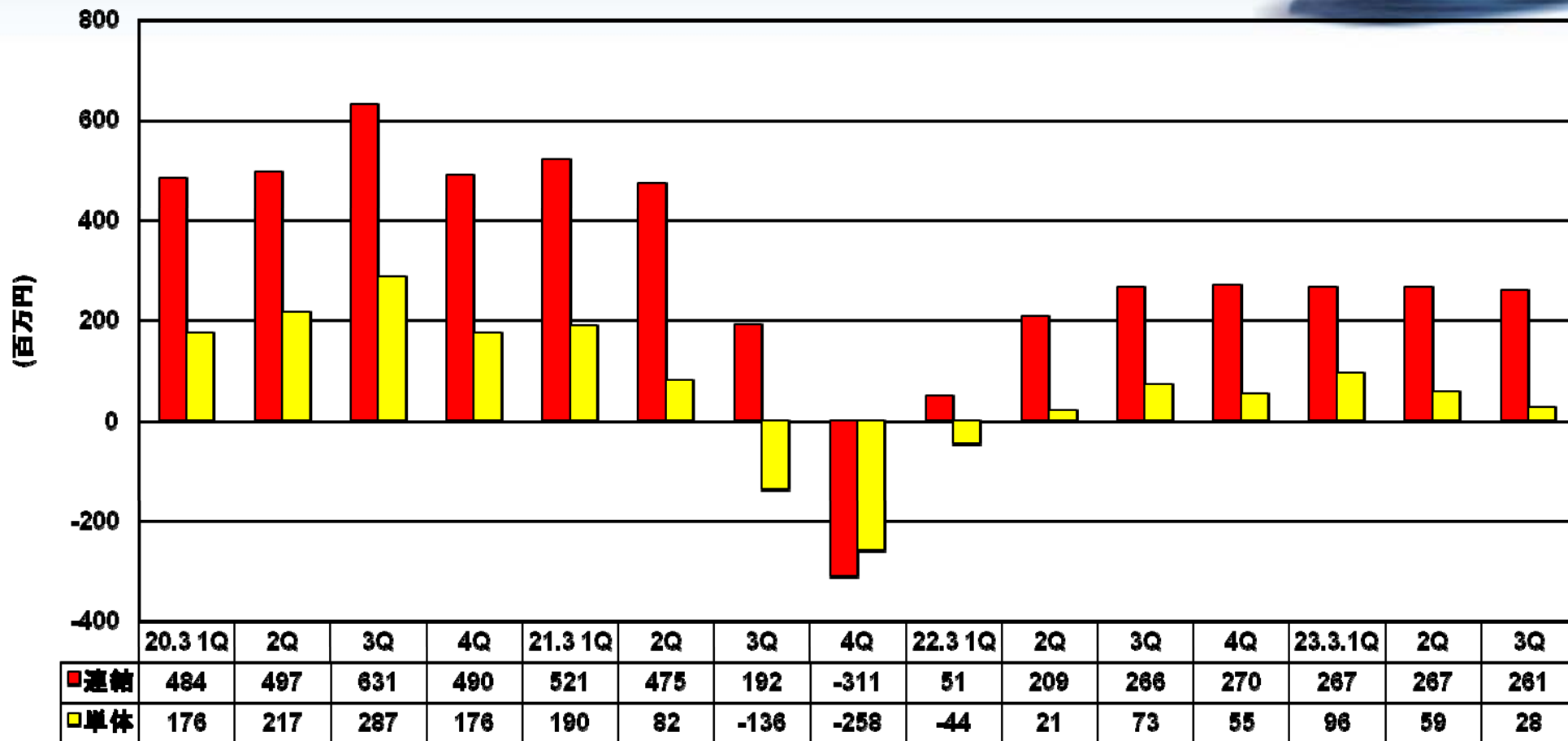
平成23年3月期第3Q業績のポイント

1)	売上高	53億50百万円	対前年比 22.6%増
	営業利益	7億97百万円	対前年比 51.2%増
	経常利益	7億78百万円	対前年比 45.6%増
	純利益	5億54百万円	対前年比 20.2%増
2)	薬品売上高	47億 8百万円	売上高に占める割合 88.0% [前年同期 40億59百万円、93.0%]
3)	海外売上げ高比率	43.9%	前年同期 44.4%
4)	CZの売上げ高	25億30百万円	薬品売上高に占める割合53.7% [前年同期22億10百万円、54.4%]

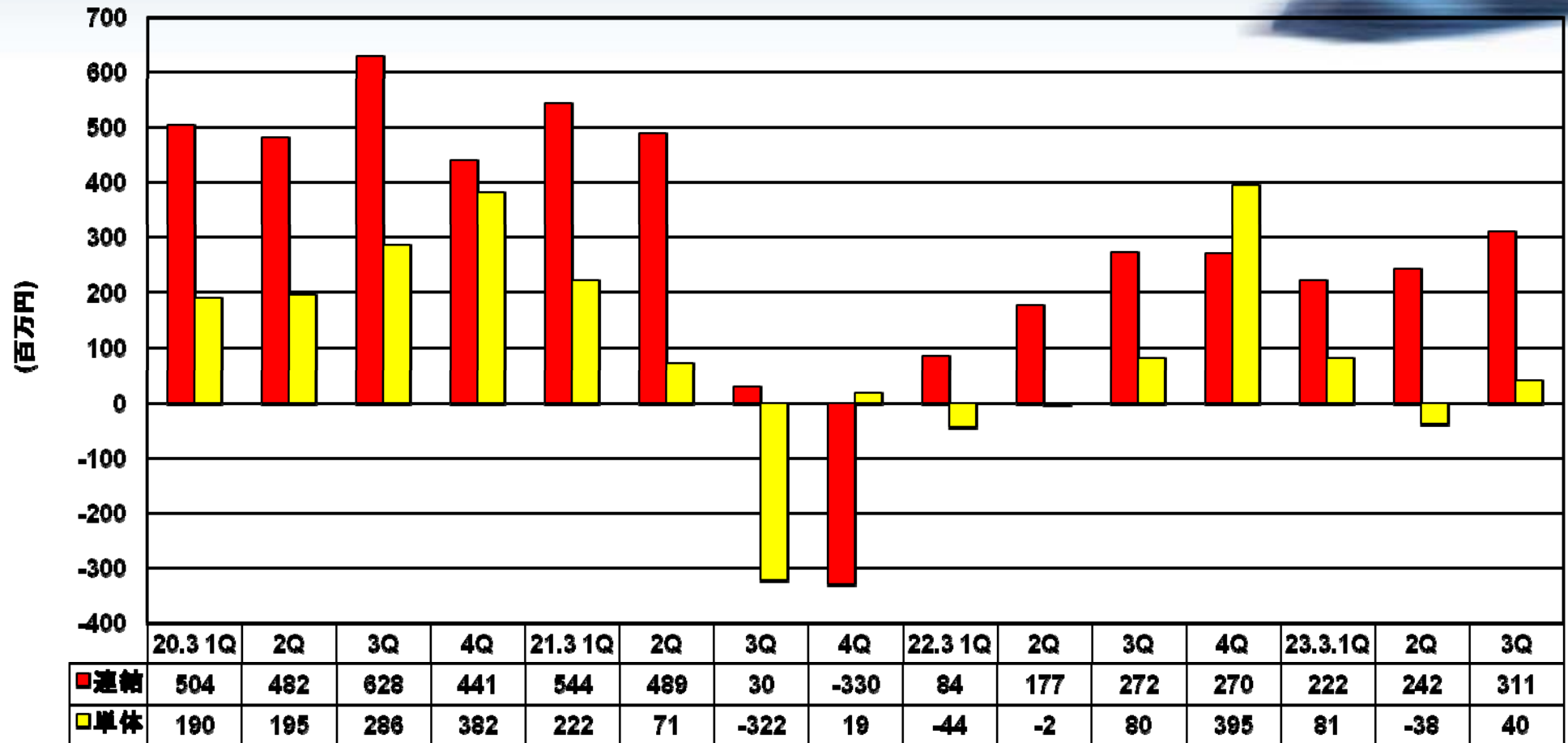
四半期売上高推移



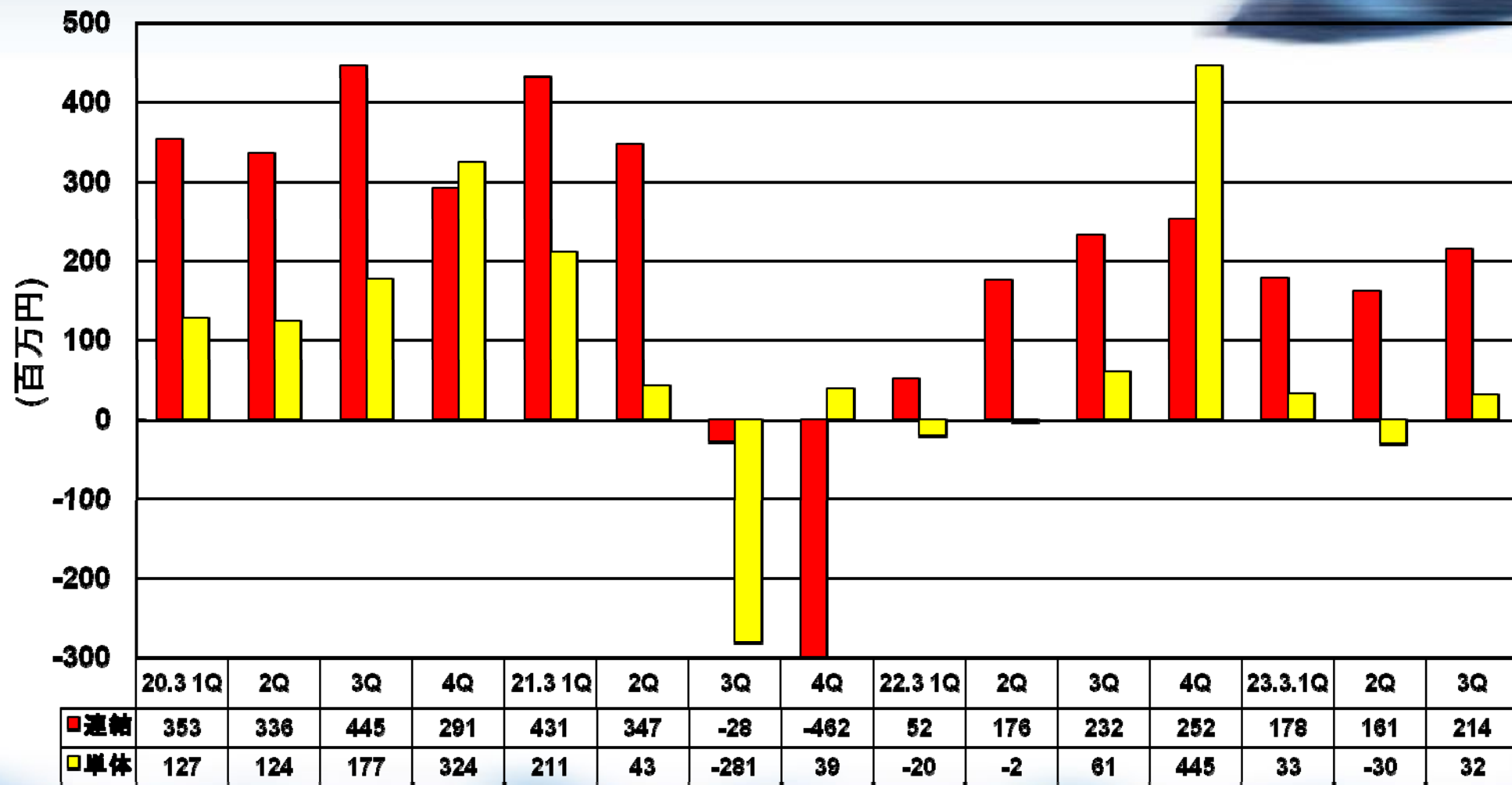
四半期 営業利益推移



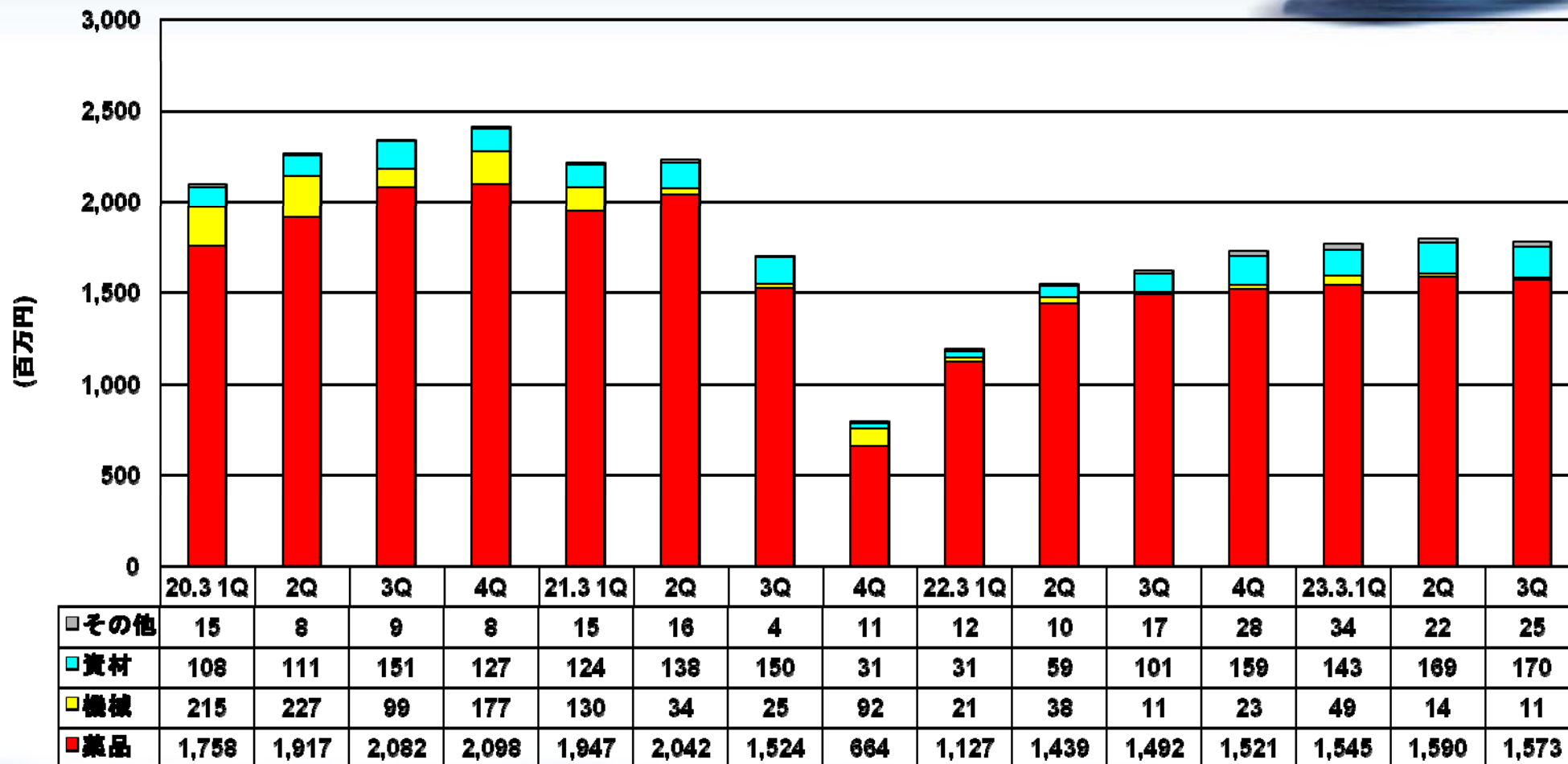
四半期 経常利益推移



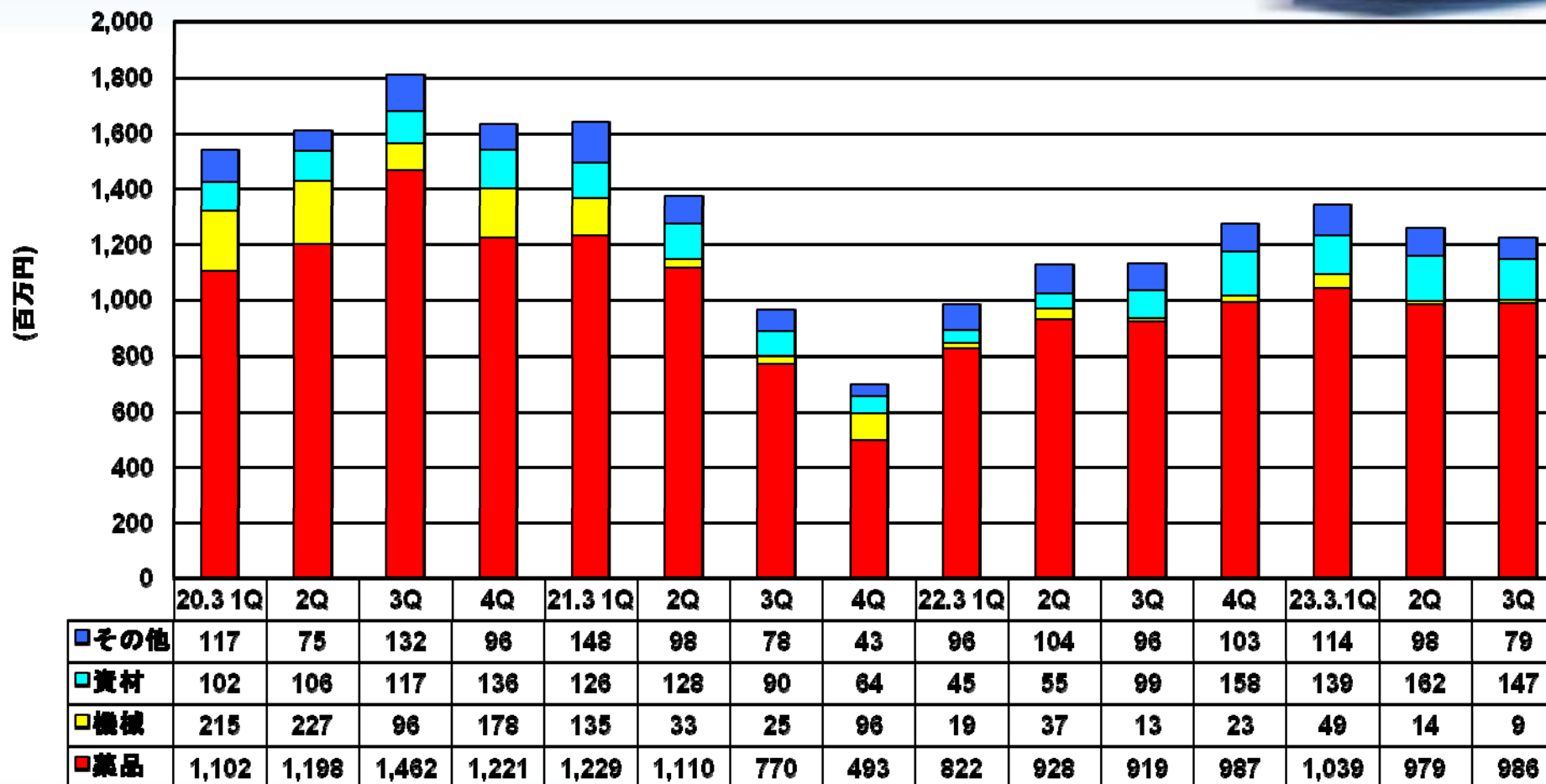
四半期 純利益推移



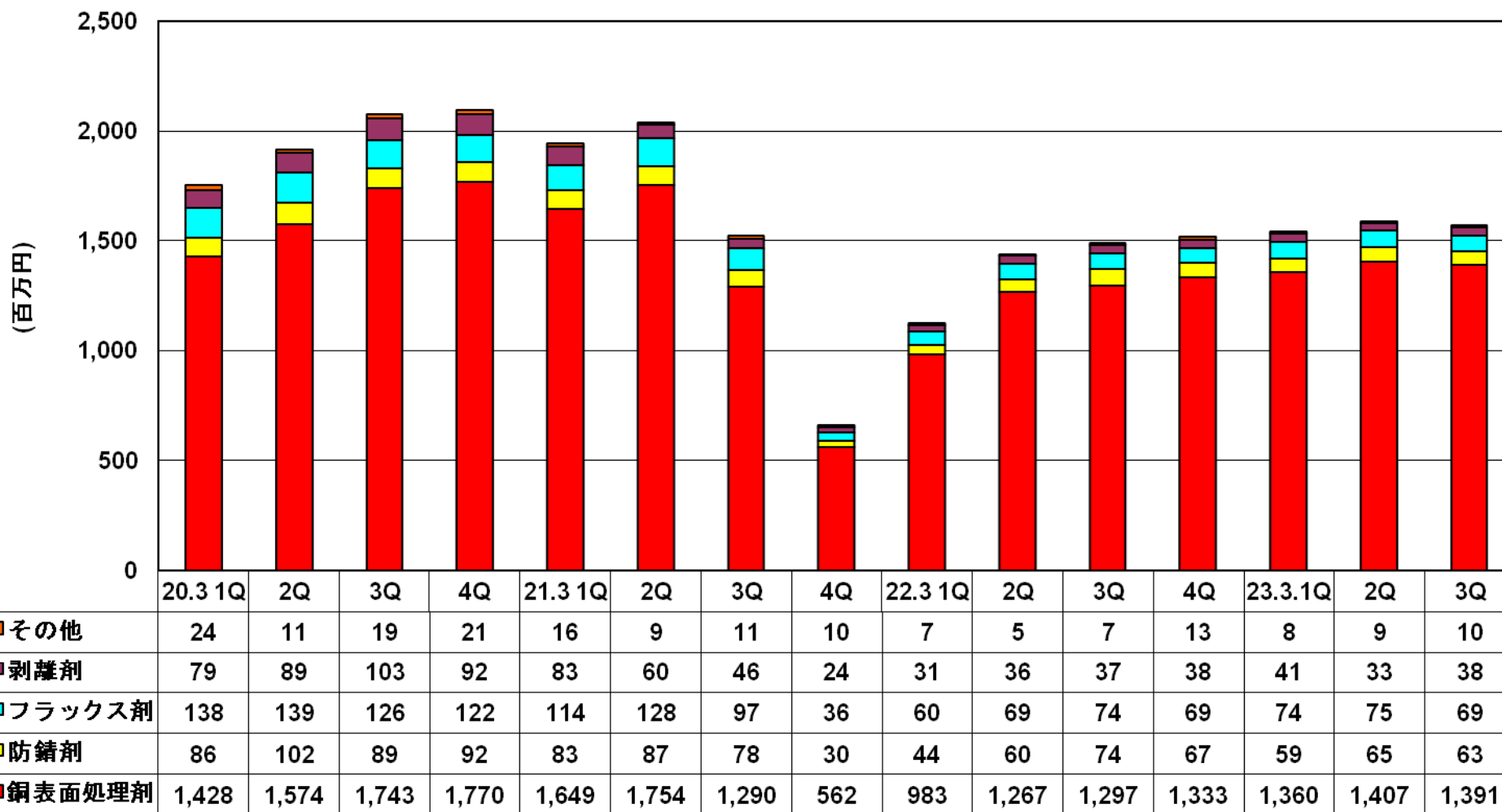
品種別四半期推移 《連結》



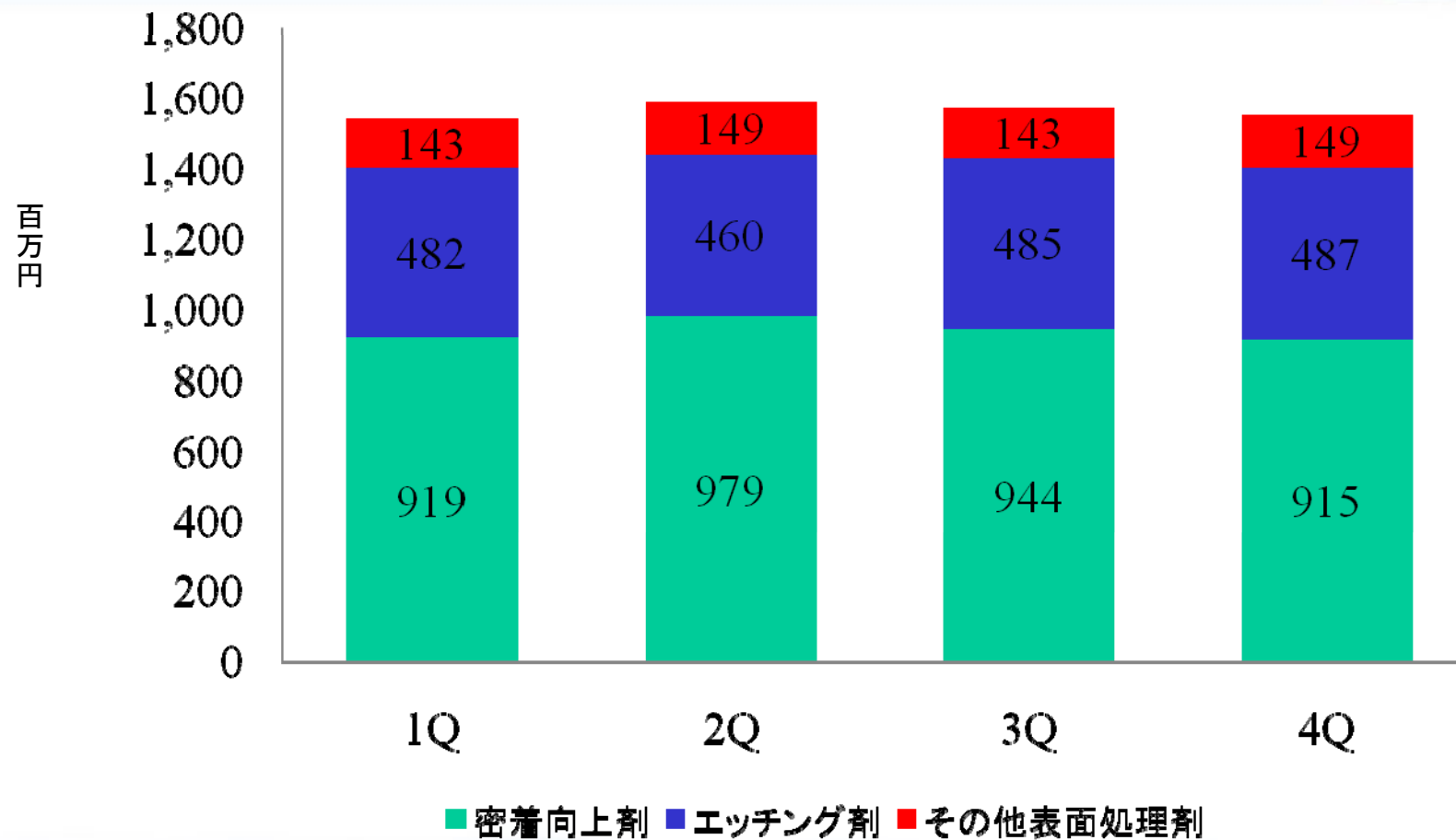
品種別四半期推移 < 単体 >



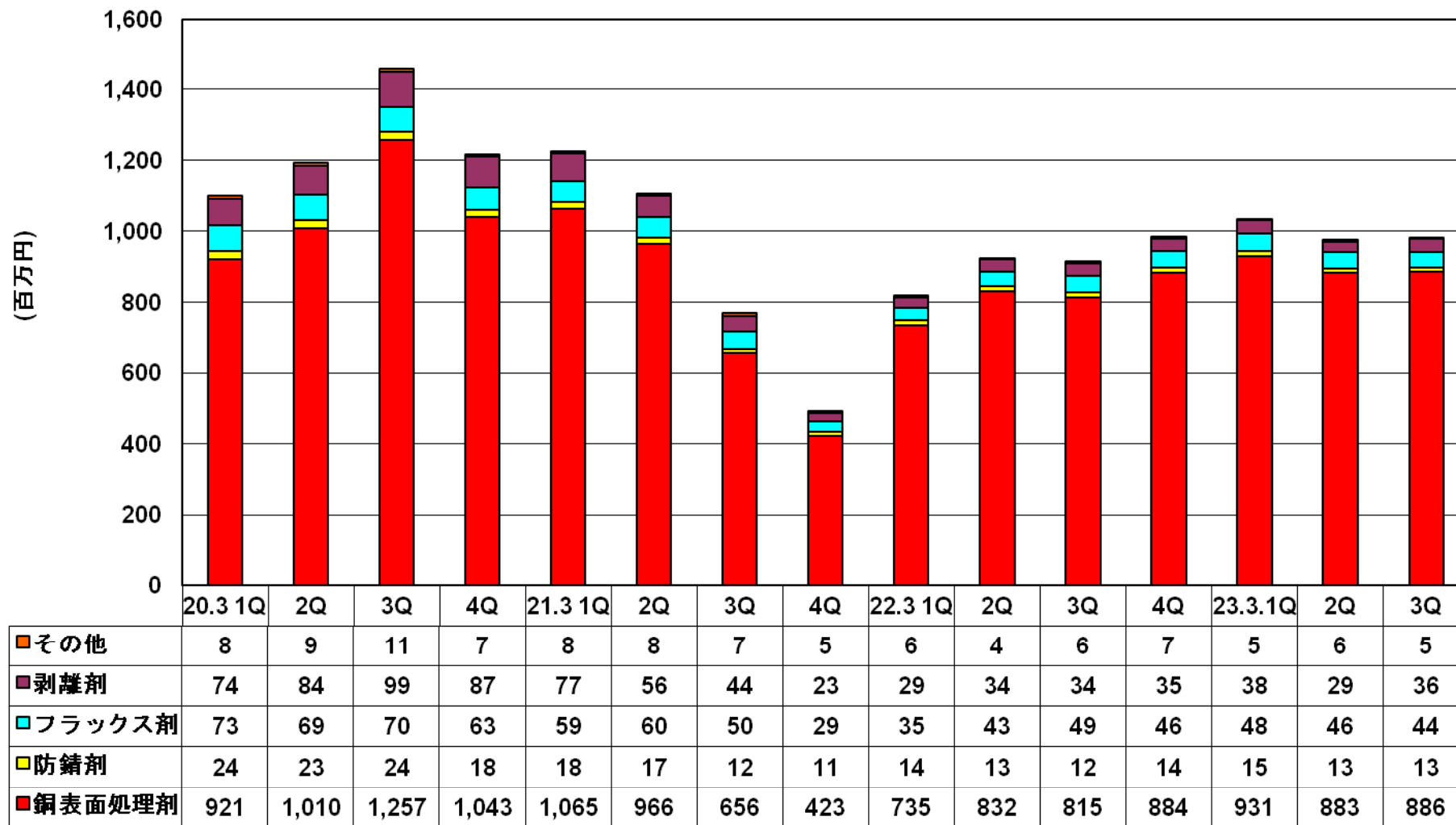
薬品別四半期推移 《連結》



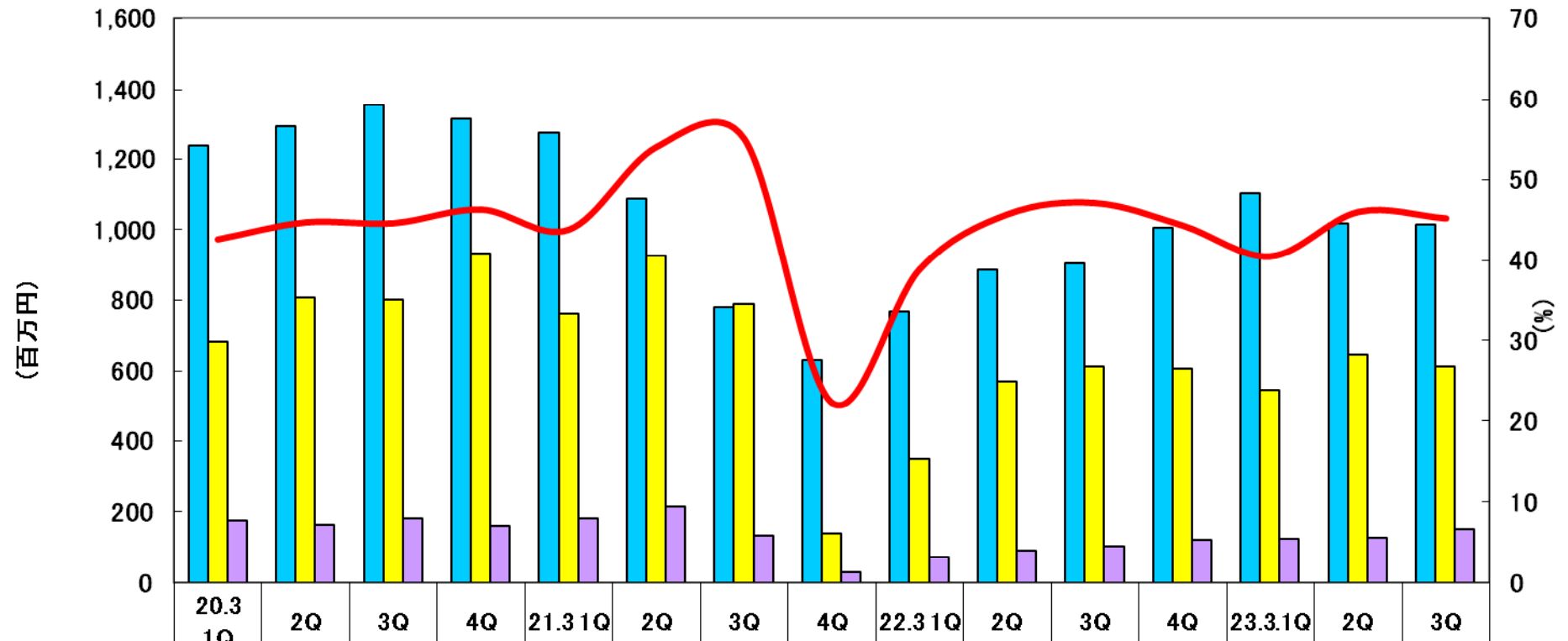
薬品分類の改編について



薬品別四半期推移 < 単体 >

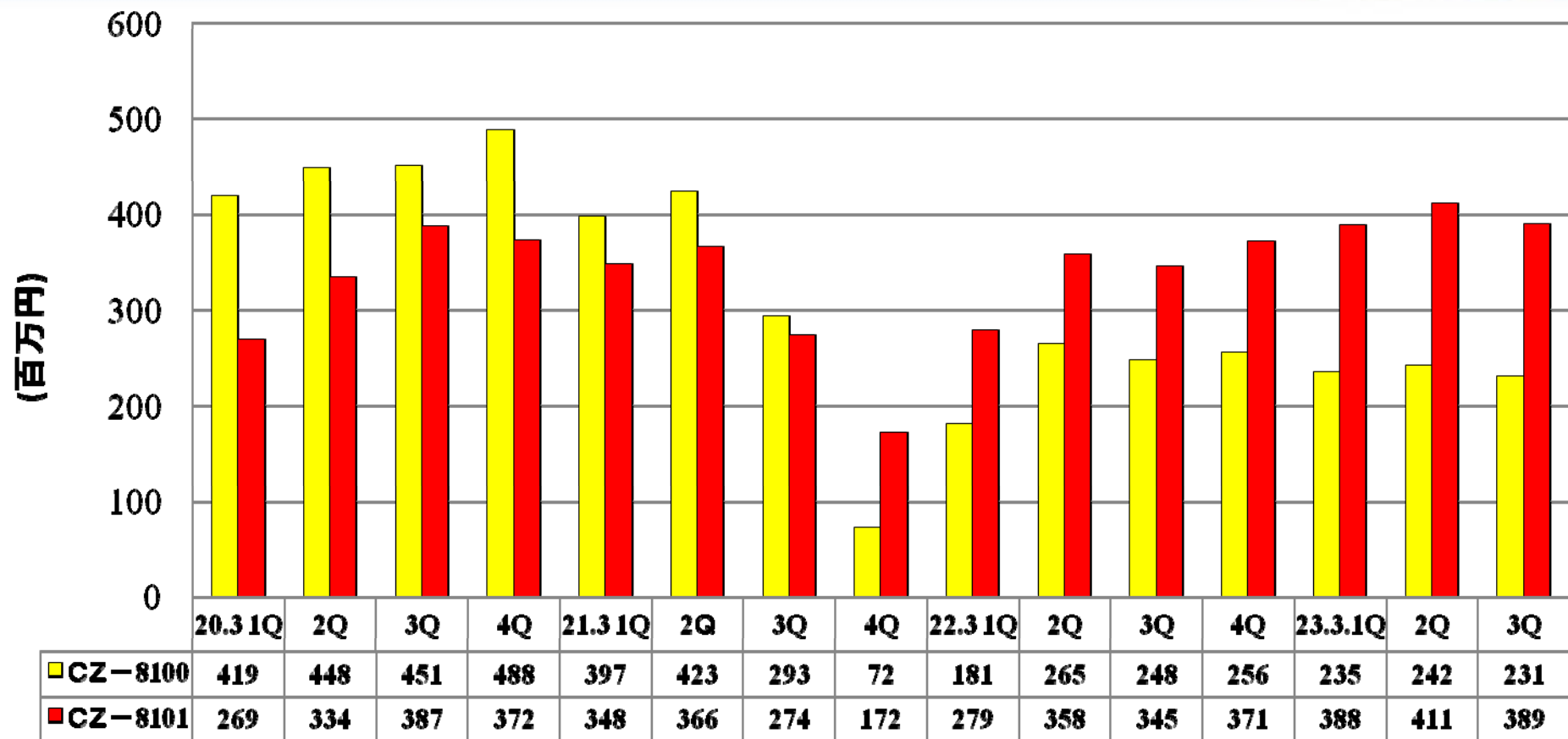


地域セグメント別売上高推移と海外比率



■ 日本	1,237	1,291	1,354	1,315	1,273	1,089	781	630	768	887	904	1,006	1,102	1,019	1,014
■ アジア	682	807	803	932	762	926	789	140	350	569	612	605	545	647	614
■ 欧州	177	165	183	163	182	216	133	29	74	91	105	121	124	129	152
— 海外売上高比率	42.6	44.7	44.6	46.3	43.8	54.0	55.0	22.3	38.9	45.7	47.1	44.3	40.5	46.0	45.2

CZシリーズ売上高推移

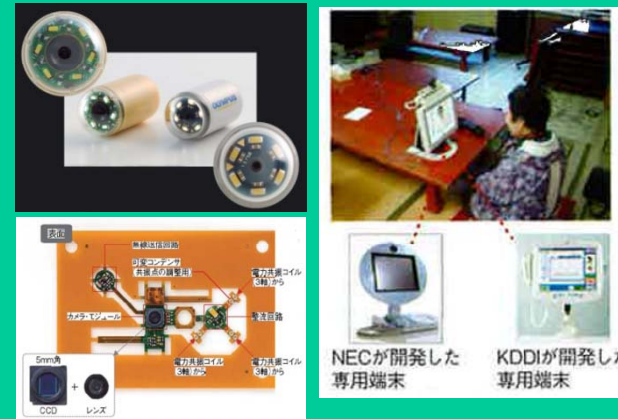


今後拡大するアプリケーション

電気自動車



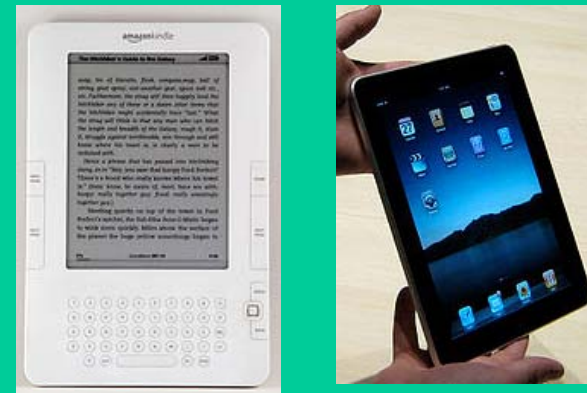
医療エレ



スマートフォン



電子書籍



スマートフォン以外でも今年期待できるモノ

・iPad2の発売によりタブレットPCの方向性が決定



- ・グラフィック統合CPUの登場
- ・3DSの登場による今後の3Dの展開
- ・新型携帯ゲーム機の販売



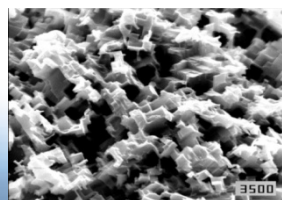
より高性能な表面処理剤が必要

様々な金属表面処理(新市場用)

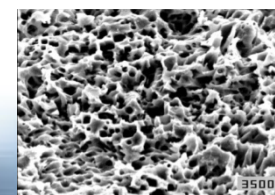
注意: 金属表面処理は、それぞれの状態により変化する可能性があります。

		金属表面処理											
		Cu	Ni	Sn	Al	Cr	Co	Mo	In	Bi	Ta	Ni-Cr	ITO
金属表面非処理	Cu		○	○	○	○	○					○	○
	Ni	○		○	○			○					
	Sn	○			○			○					
	Al	○					○	○	○	○			
	Cr	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
	Co	○		○	○	○		○				○	○
	Mo	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	In	○		○	○			○					
	Bi	○		○	○			○					
	Ta	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○
	Ni-Cr	○	○	○	○		○	○					
	ITO	○	○	○	○		○	○	○	○	○		

アルミ表面



ニッケル表面



今後の計画ポイント

1. 高密度電子基板 “量産用新プロセス”の
実用化
2. 多層電子基板製造用プロセスを通じて、
客先の環境負荷低減に寄与する取組み
3. ‘銅表面処理’から“金属表面処理”へ。
様々な用途への適用を目指す